

2023年3月期
決算説明資料

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2023年5月12日

2023年3月期 決算概要

【連結会計期間】

日本国内(2社)：4月～3月／海外(10社)：1月～12月

● 表面処理用資材事業

- 主力のパッケージ基板向けめっき薬品は、パソコンやデータセンター向けに使用されるパッケージ基板の在庫調整による影響を後半に受けましたが、前半の好調に加え、比較的影響が少なかったカーエレクトロニクス市場の堅調な需要や為替相場の円安による効果も寄与し、前連結会計年度を上回りました。

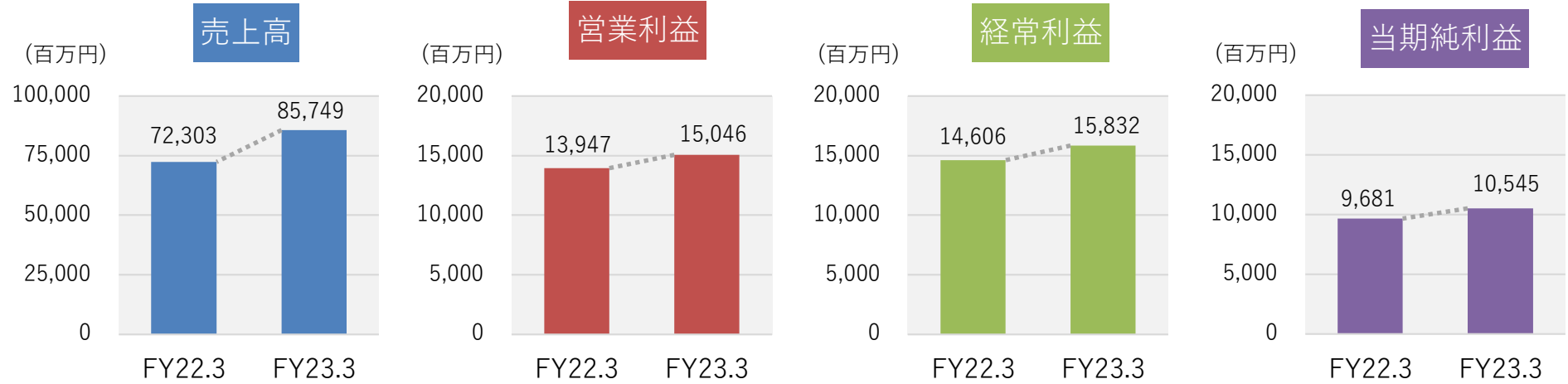
● 表面処理用機械事業

- 日本、台湾および中国市場を中心に半導体や電子部品向けの表面処理用機械の需要が好調に推移し、前連結会計年度を上回りました。

● めっき加工事業

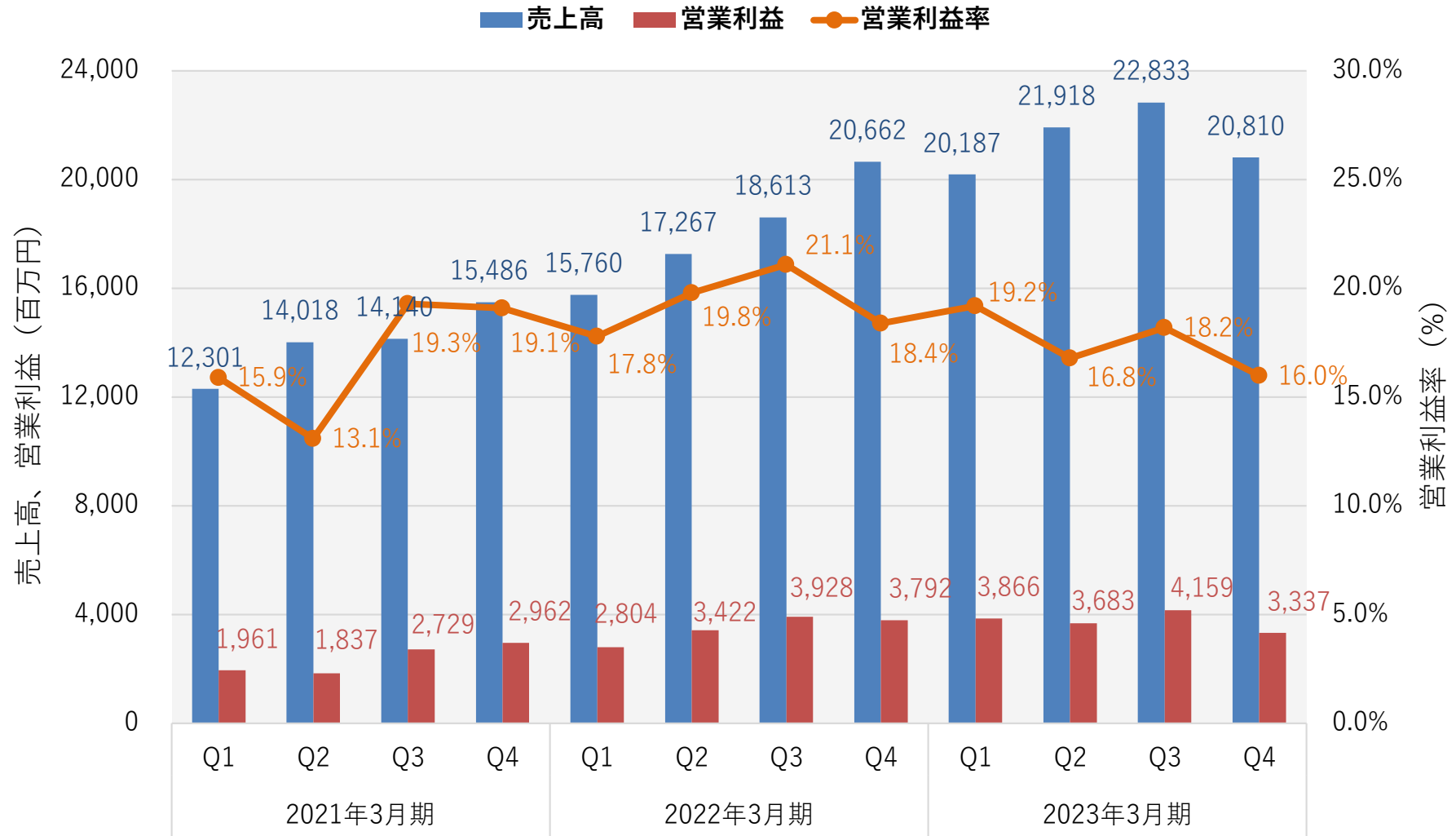
- タイやインドネシアの自動車産業向けプラめっき加工は回復には至ってありませんが、台湾で行っているパッケージ基板加工が好調で大幅な落ち込み状態を脱する事ができました。売上高は前連結会計年度を上回りましたが、利益面で非鉄金属等(Ni)の原材料価格の高騰による影響を受けました。

2023年3月期 決算概要



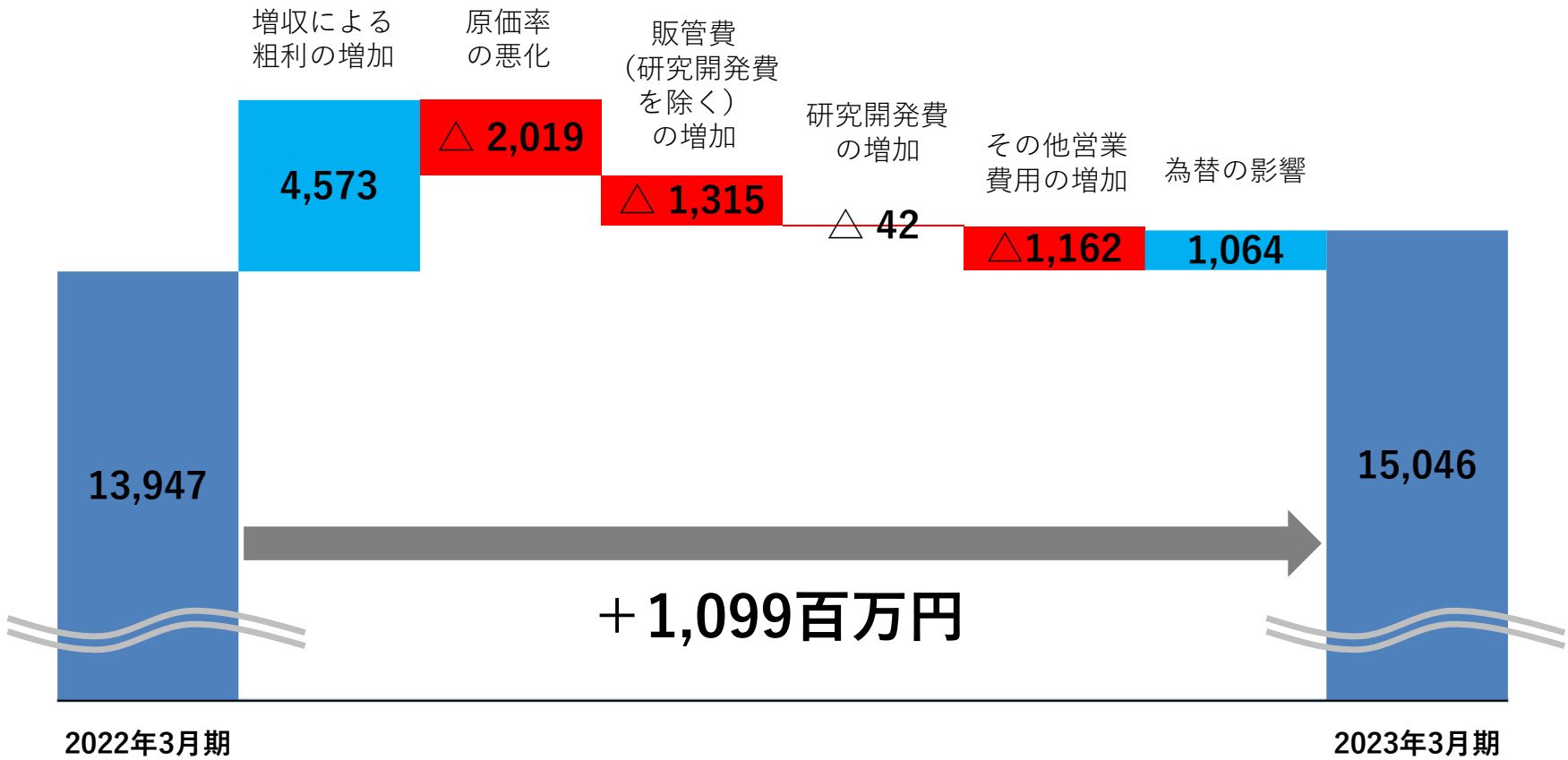
(単位：百万円)	2022年3月期 実績	2023年3月期 予想(2022.11.11修正)	2023年3月期 実績	前期比	予想比
売上高	72,303	82,000	85,749	+ 13,446 (+ 18.6%)	+ 3,749 (+ 4.6%)
営業利益	13,947	14,000	15,046	+ 1,099 (+ 7.9%)	+ 1,046 (+ 7.5%)
経常利益	14,606	14,600	15,832	+ 1,226 (+ 8.4%)	+ 1,232 (+ 8.4%)
当期純利益	9,681	10,900	10,545	+ 864 (+ 8.9%)	△ 355 (△ 3.3%)
為替：米ドル	109.90円	133.28円	131.62円	21.72円安	1.66円高

四半期毎の業績推移

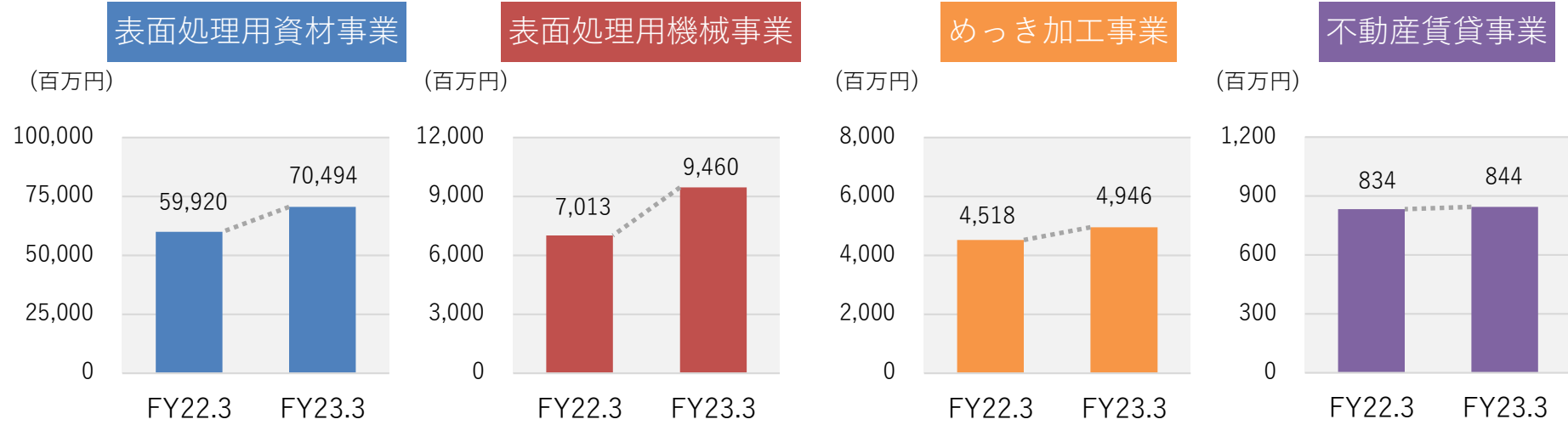


営業利益の増減要因

(単位：百万円)



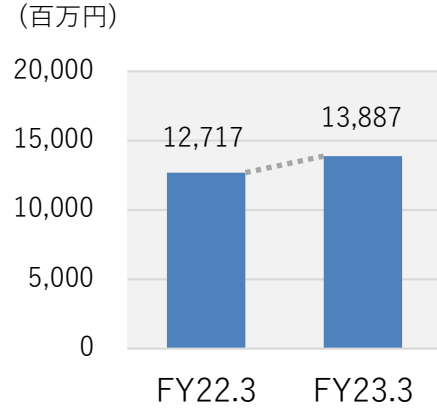
事業セグメント別売上高



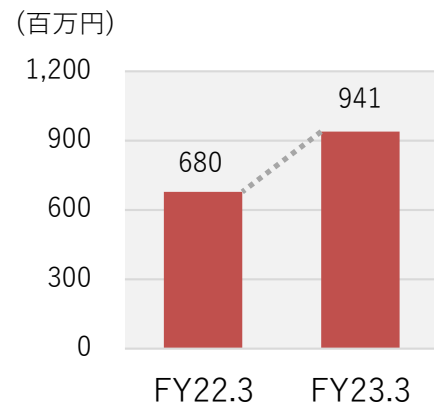
(単位：百万円)	2022年3月期 実績	2023年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	59,920	70,494	+ 10,574	+ 17.6%
表面処理用機械	7,013	9,460	+ 2,446	+ 34.9%
めっき加工	4,518	4,946	+ 428	+ 9.5%
不動産賃貸	834	844	+ 10	+ 1.2%

事業セグメント別営業利益

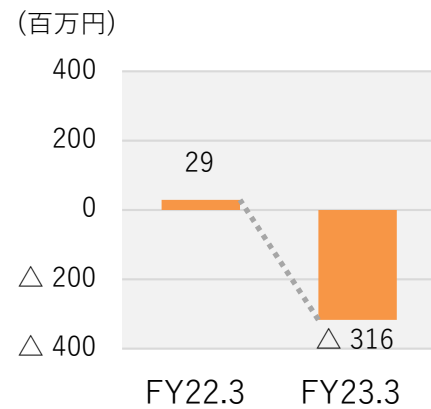
表面処理用資材事業



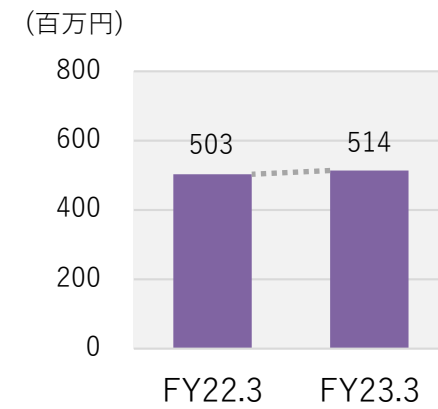
表面処理用機械事業



めっき加工事業

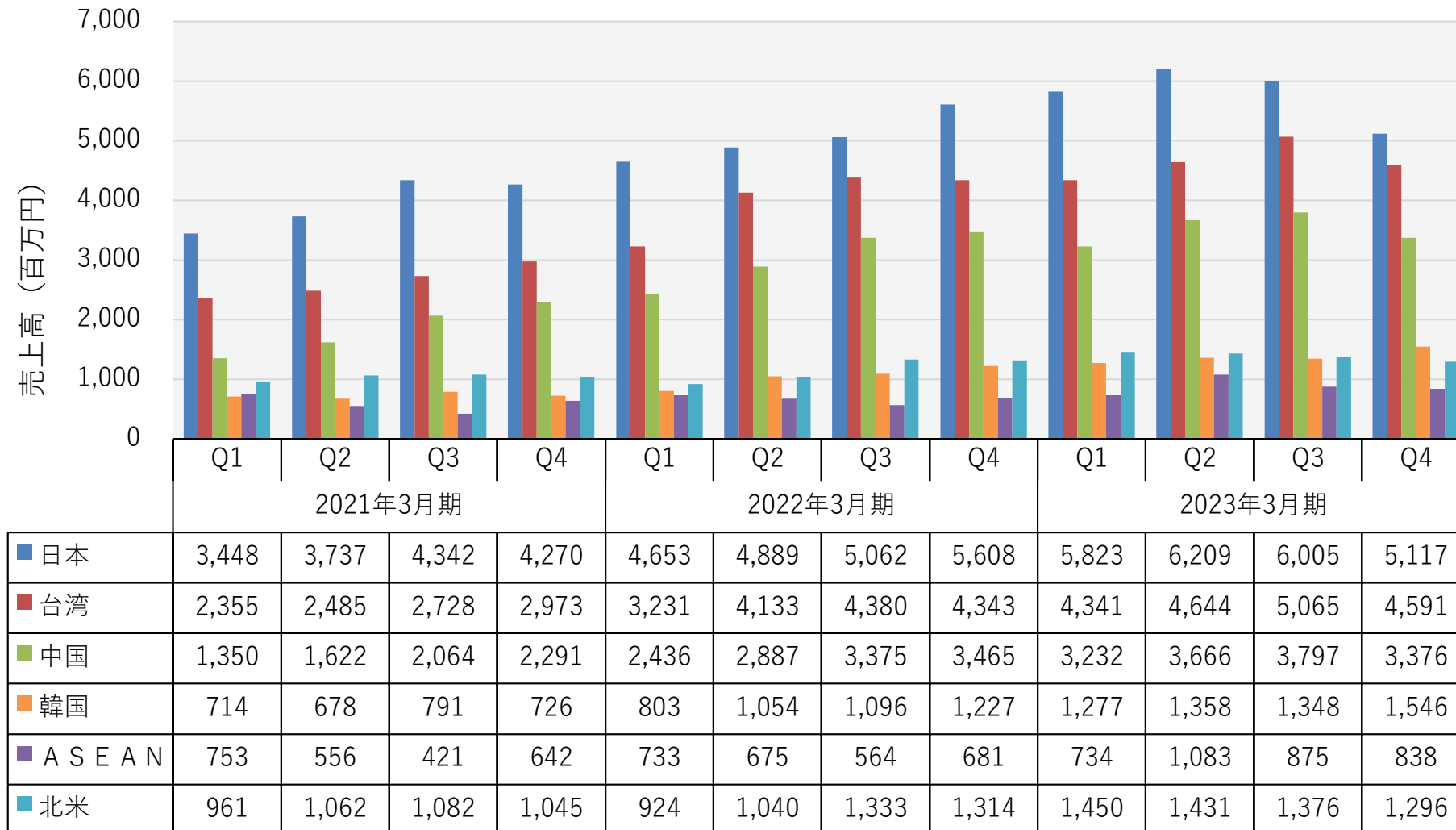


不動産賃貸事業

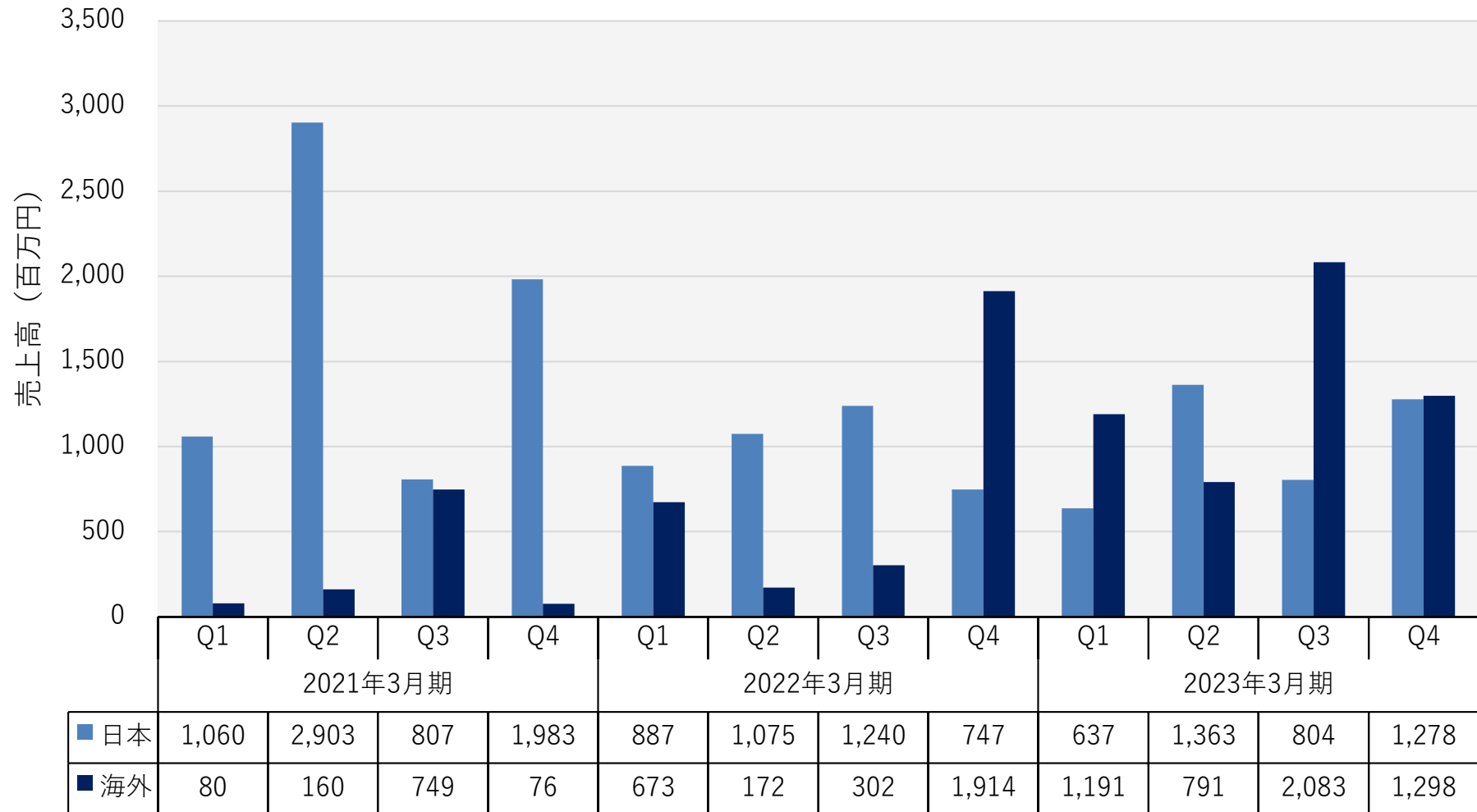


(単位：百万円)	2022年3月期 実績	2023年3月期 実績	増減額	増減率
表面処理用資材	12,717	13,887	+ 1,170	+ 9.2%
表面処理用機械	680	941	+ 261	+ 38.3%
めっき加工	29	△ 316	△ 345	-
不動産賃貸	503	514	+ 10	+ 2.1%

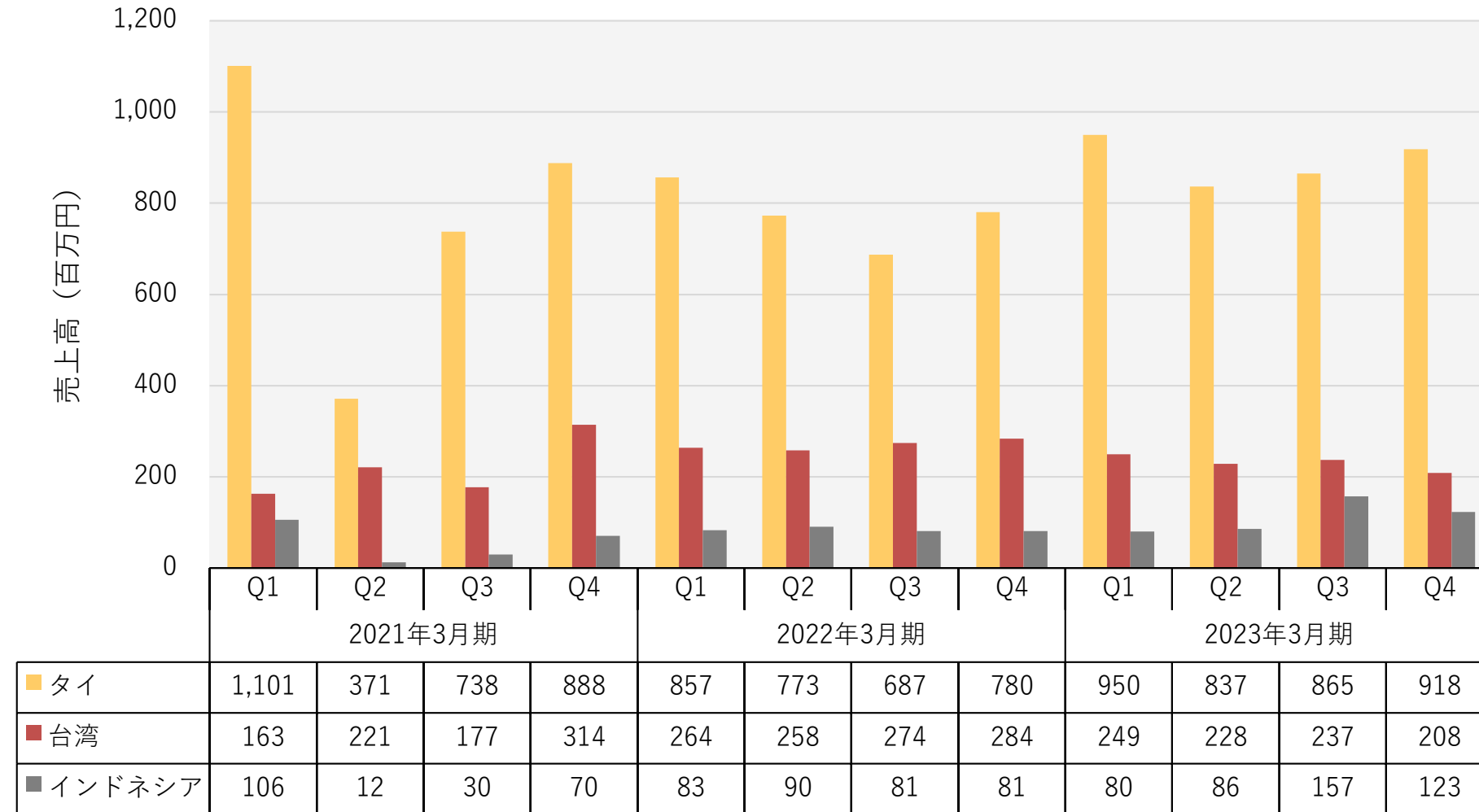
表面处理用資材事業 売上高推移



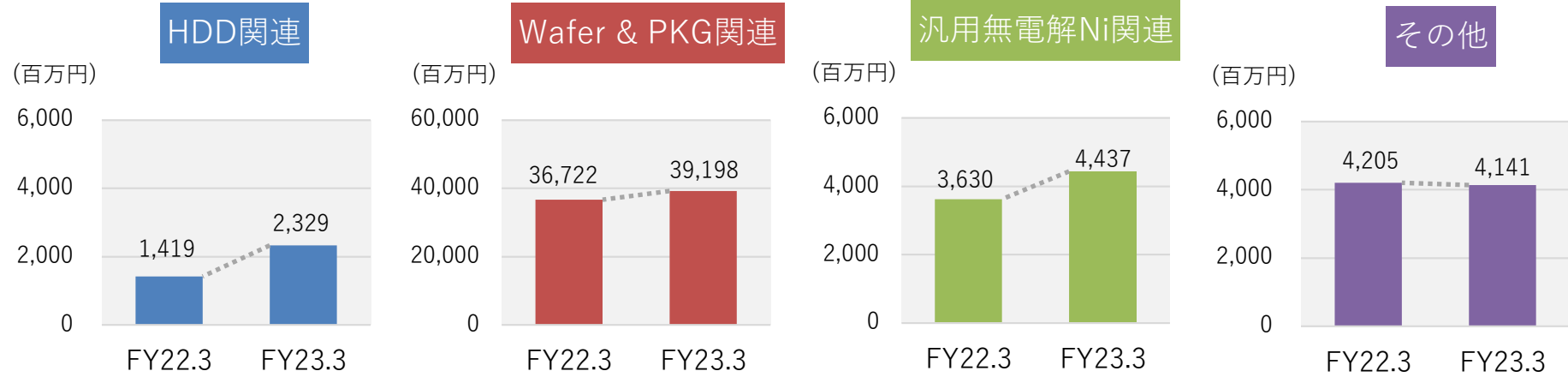
表面処理用機械事業 売上高推移



めっき加工事業 売上高推移



薬品カテゴリー別売上高



(単位：百万円)	2022年3月期実績		2023年3月期実績		増減額	増減率
		構成比		構成比		
HDD関連	1,419	3.1%	2,329	4.6%	+ 909	+ 64.1%
Wafer & PKG関連	36,722	79.9%	39,198	78.2%	+ 2,476	+ 6.7%
汎用無電解Ni関連	3,630	7.9%	4,437	8.9%	+ 807	+ 22.2%
薬品その他	4,205	9.1%	4,141	8.3%	△ 63	△ 1.5%
合計	45,977	100.0%	50,107	100.0%	+ 4,129	+ 9.0%

薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

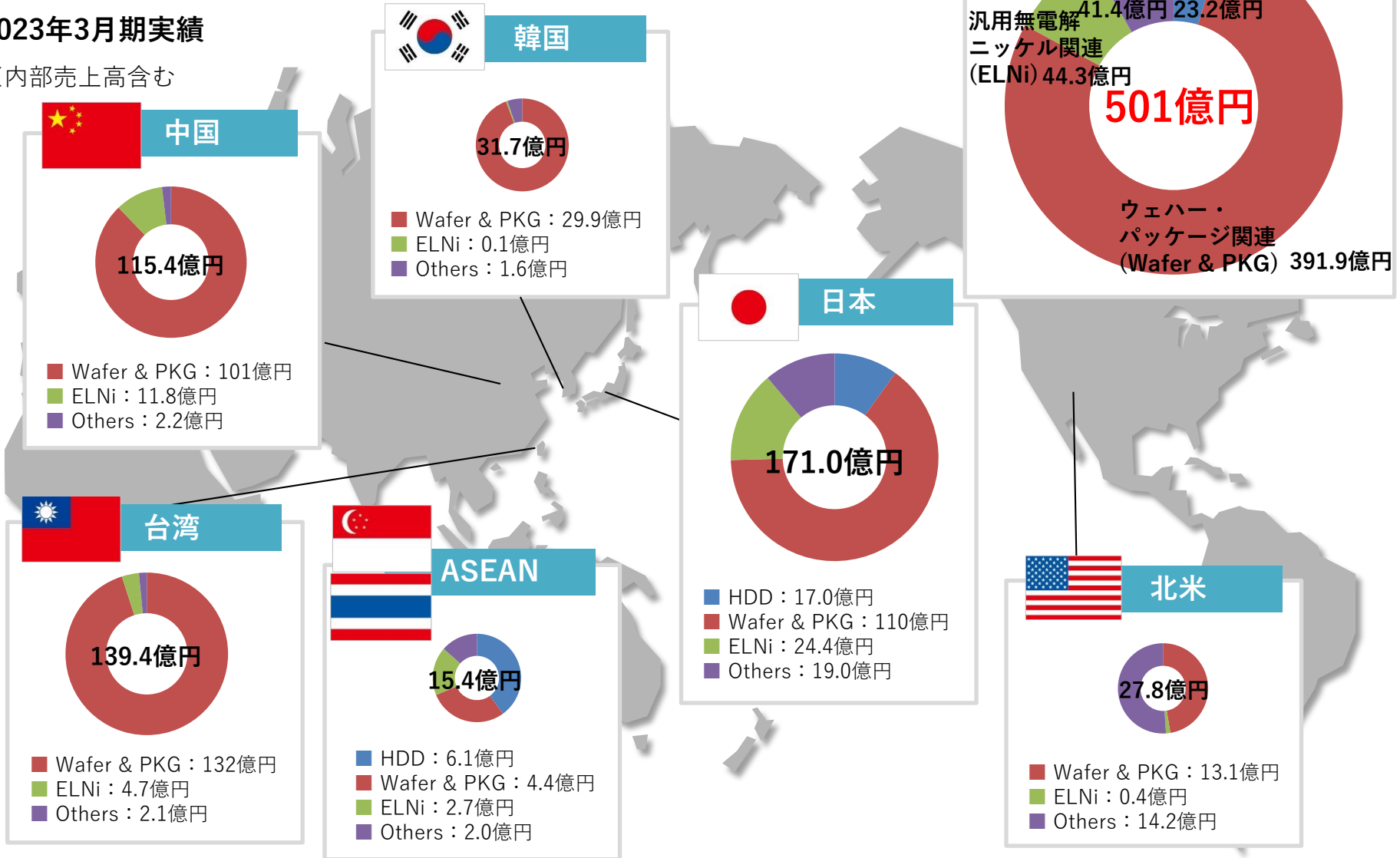
薬品ビジネス 最終製品までの流れ



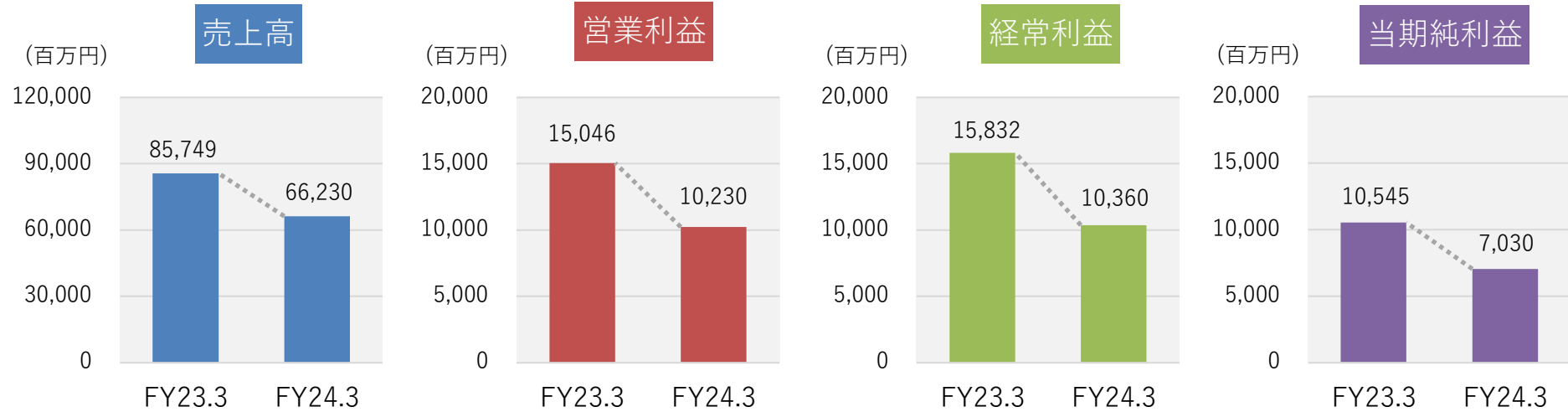
地域別薬品売上高

2023年3月期実績

※内部売上高含む



2024年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	増減額	増減率
売上高	85,749	66,230	△ 19,519	△ 22.8%
営業利益	15,046	10,230	△ 4,816	△ 32.0%
経常利益	15,832	10,360	△ 5,472	△ 34.6%
当期純利益	10,545	7,030	△ 3,515	△ 33.3%
為替：米ドル	131.62円	133.53円	1.91円安	

2024年3月期 通期業績予想

● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	増減額	増減率	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	増減額	増減率
表面処理用資材	70,494	49,268	△ 21,226	△ 30.1%	13,887	8,845	△ 5,042	△ 36.3%
表面処理用機械	9,460	11,833	+ 2,372	+ 25.1%	941	1,043	+ 101	+ 10.8%
めっき加工	4,946	4,393	△ 553	△ 11.2%	△ 316	85	+ 401	-
不動産賃貸	844	722	△ 122	△ 14.5%	514	246	△ 268	△ 52.2%

● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想	増減額	増減率
HDD関連	2,329	2,100	△ 229	△ 9.9%
Wafer & PKG関連	39,198	29,580	△ 9,618	△ 24.5%
汎用無電解Ni関連	4,437	3,475	△ 962	△ 21.7%
薬品その他	4,141	3,415	△ 726	△ 17.5%
合計	50,107	38,570	△ 11,537	△ 23.0%

<参考> 為替感応度

2024年3月期想定レート：133.53円(JPY/USD)

円安に1円振れると通期で

- ・ 売上：約330百万円増
- ・ 営業利益：約30百万円増

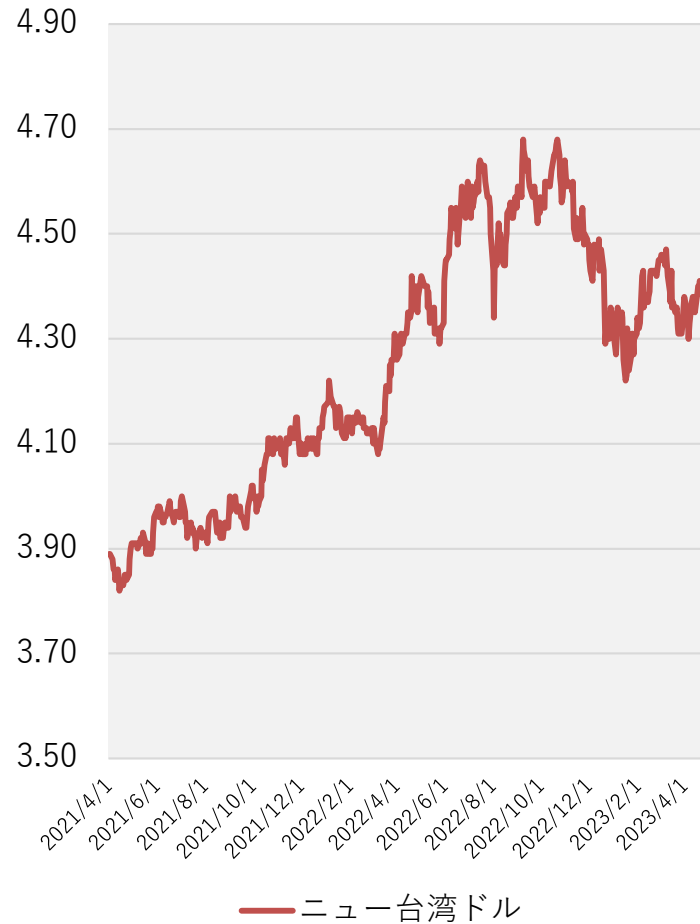
円高に1円振れると通期で

- ・ 売上：約330百万円減
- ・ 営業利益：約30百万円減

※米ドル以外の通貨も連動して動くことを想定しています。

為替レートの推移

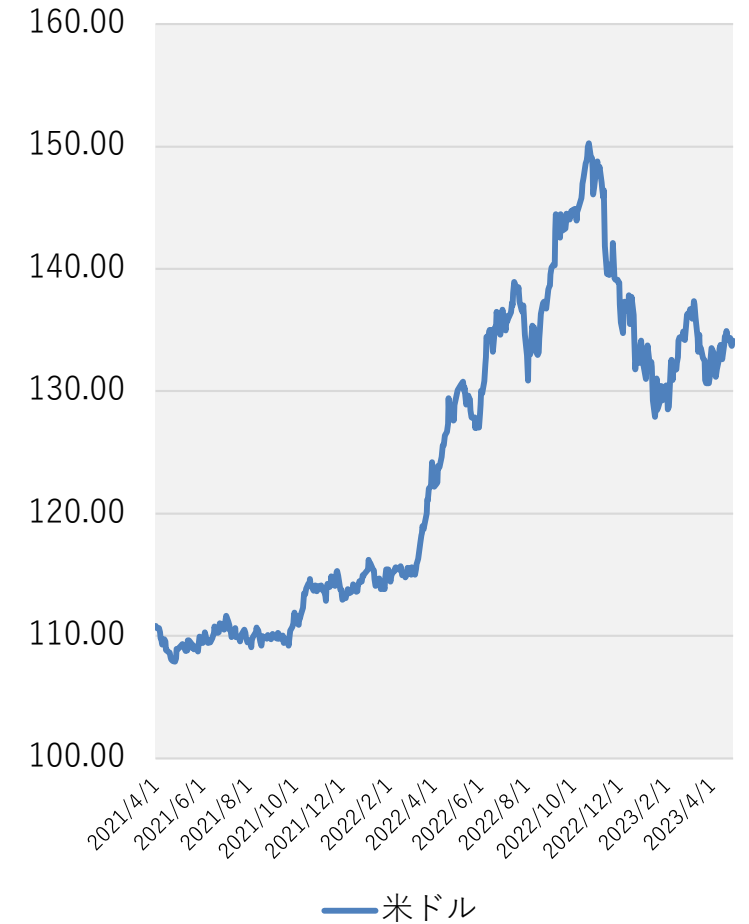
ニュー台湾ドル



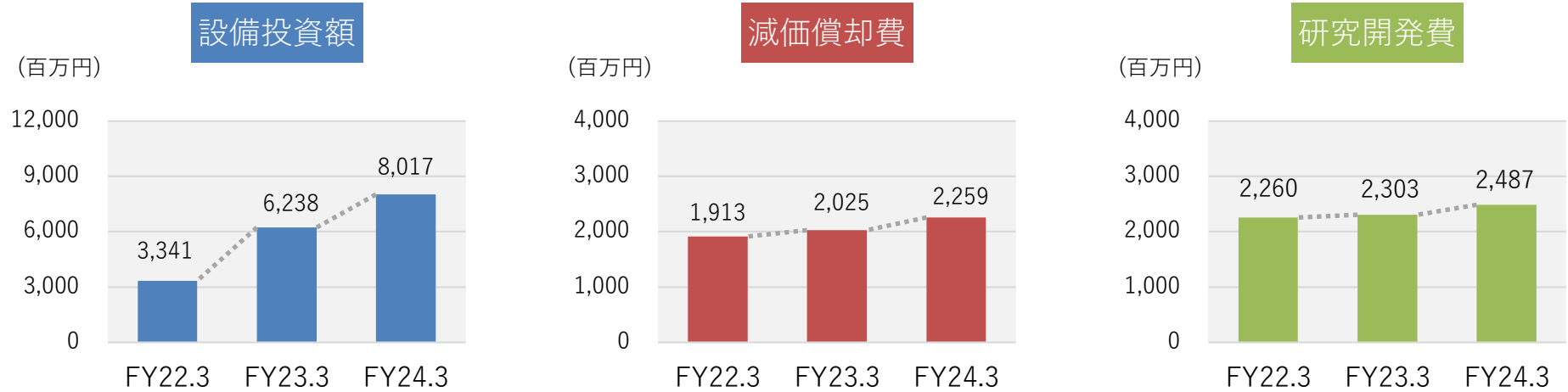
人民元



米ドル



設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	2022年3月期 実績	2023年3月期 実績	2024年3月期 予想
設備投資額	3,341	6,238	8,017
減価償却費	1,913	2,025	2,259
研究開発費	2,260	2,303	2,487

資本政策

安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を基本方針とした資本政策に取り組んでいます

連結総還元性向 50%、ROE 8.5%を目標

2022年3月期-2024年3月期の3年間で60億円規模の弾力的な自己株式取得を実施
中長期的にはROE 10%を目指す

- ・ 総還元性向による安定した配当の実現と自己株式取得の機動的な実施
- ・ 経済状況、財務状況等を総合的に勘案した弾力的な自己株式取得の実施
- ・ 将来の成長が見込まれる分野や地域、新たな技術取得、M&A、想定外の事態や自然災害に備えた内部留保の確保

※当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として、またM&A戦略（M&Aや業務資本提携等）を実施するため、その対価として一定の自己株式を保有します。

※M&A戦略を実施しなかった場合は、発行済株式総数の10%を超える部分については、消却いたします。

<トピックス> 自己株式の取得について

2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得対象株式の種類：当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数：600,000 株（上限）
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.64%)
- (3) 株式の取得価額の総額：30 億円（上限）
- (4) 自己株式取得の期間：2023 年 6 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

(ご参考) 2023 年 4 月 30 日時点での自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	16,461,316 株
自己株式数	3,294,764 株

<トピックス> マレーシアにペナン事務所を開設

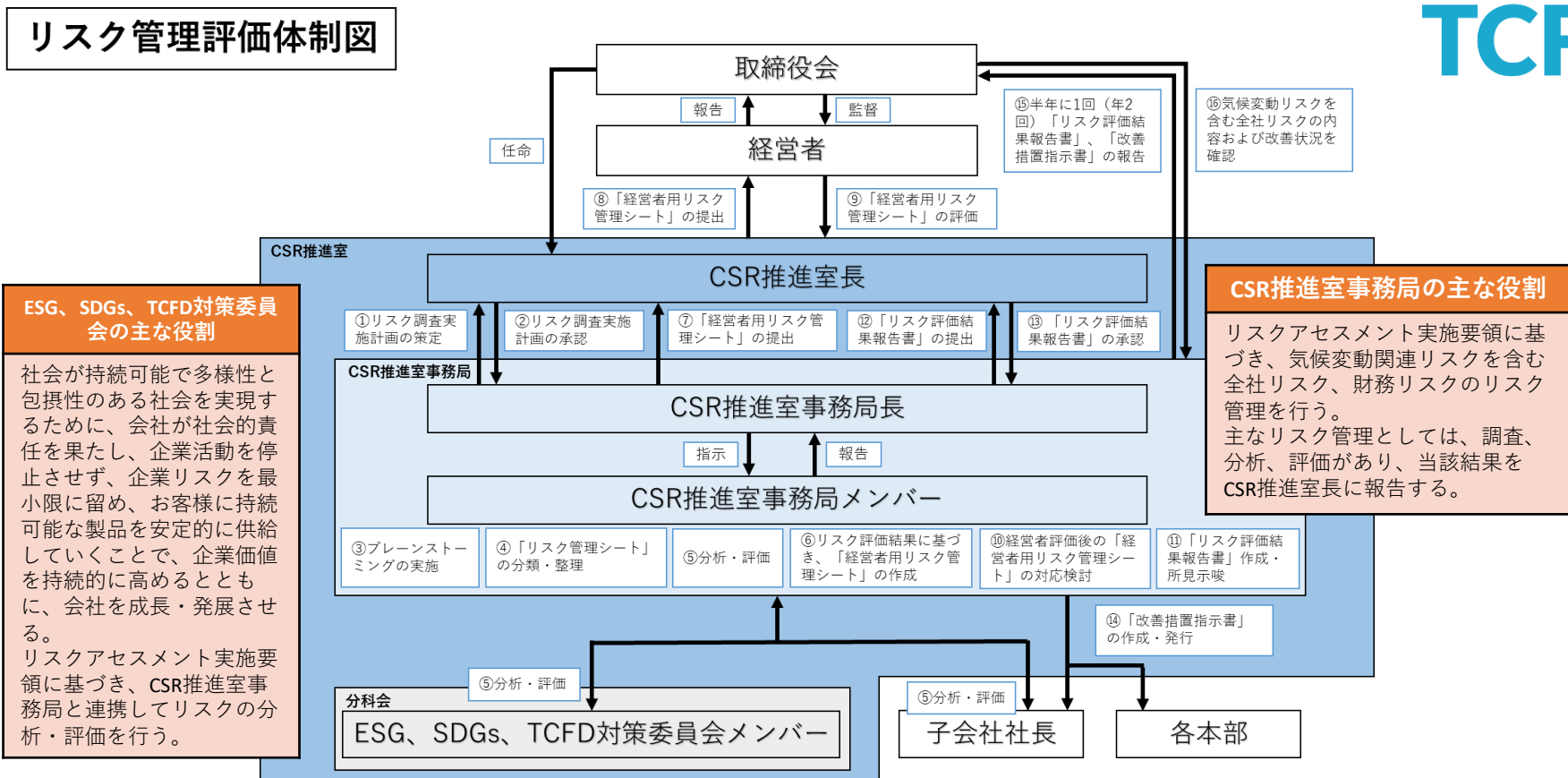
半導体・電子部品産業の需要旺盛なマレーシア・ペナン州において、顧客への技術支援業務を開始



2023年1月に開設したペナン事務所

<トピックス> TCFD提言に基づく情報開示

当社は「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識し、2023年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を表明しました。当社では、提言で示された内容に沿って、気候変動関連の情報開示に努めてまいります。

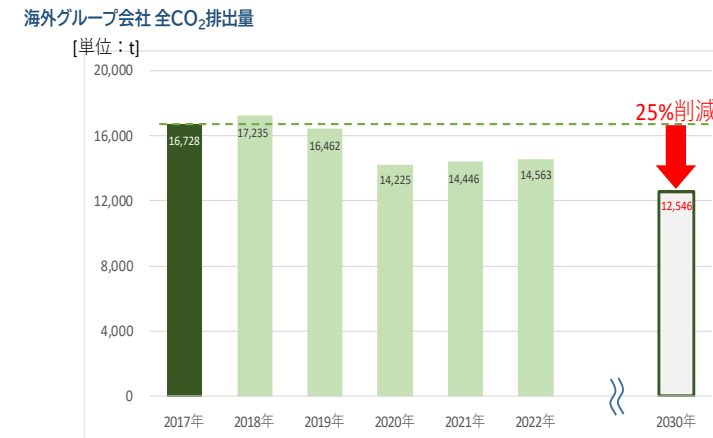
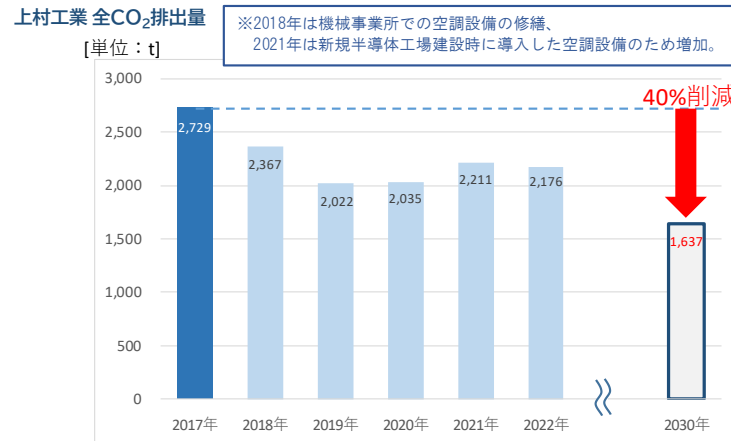


<トピックス> TCFD提言に基づく情報開示

当社グループでは、気候変動対策を重要課題と認識し、省エネルギー（太陽光発電の設置、省エネ機器の導入）をはじめとする様々なCO₂排出量の削減に取り組んでおり、2030年までに当社グループのCO₂排出量日本国内40%、海外25%削減を目指します。（2017年比）また、持続可能な社会の実現に向け2050年カーボンニュートラル（実質排出ゼロ）にチャレンジします。

CO₂排出量の2022年実績及び2030年中間目標

CO ₂ 排出量（2017年比）		
CO ₂ 排出量 （2017年比）	2022年	2030年 中間目標
上村工業	削減率 20%	削減率 40%
海外グループ会社	削減率 13%	削減率 25%



<トピックス>コーポレート・ガバナンスに対する取り組み

● 指名・報酬委員会の設置

当社は、2023年4月10日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会（以下、本委員会）を設置することを決議いたしました。本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。詳細につきましては、2023年4月10日付プレスリリース「[指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ](#)」をご確認ください。

● 取締役会の実効性評価の実施

当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。今回当社が全取締役（9名）および全監査役（3名）に対して行った自己評価の結果、「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「取締役会の議題」、「取締役会を支える体制」について適切であり、当社の取締役会の実効性は確保されていると判断しております。詳細につきましては、2023年4月10日付プレスリリース「[取締役会の実効性評価について](#)」をご確認ください。

● 譲渡制限付株式報酬制度の改定

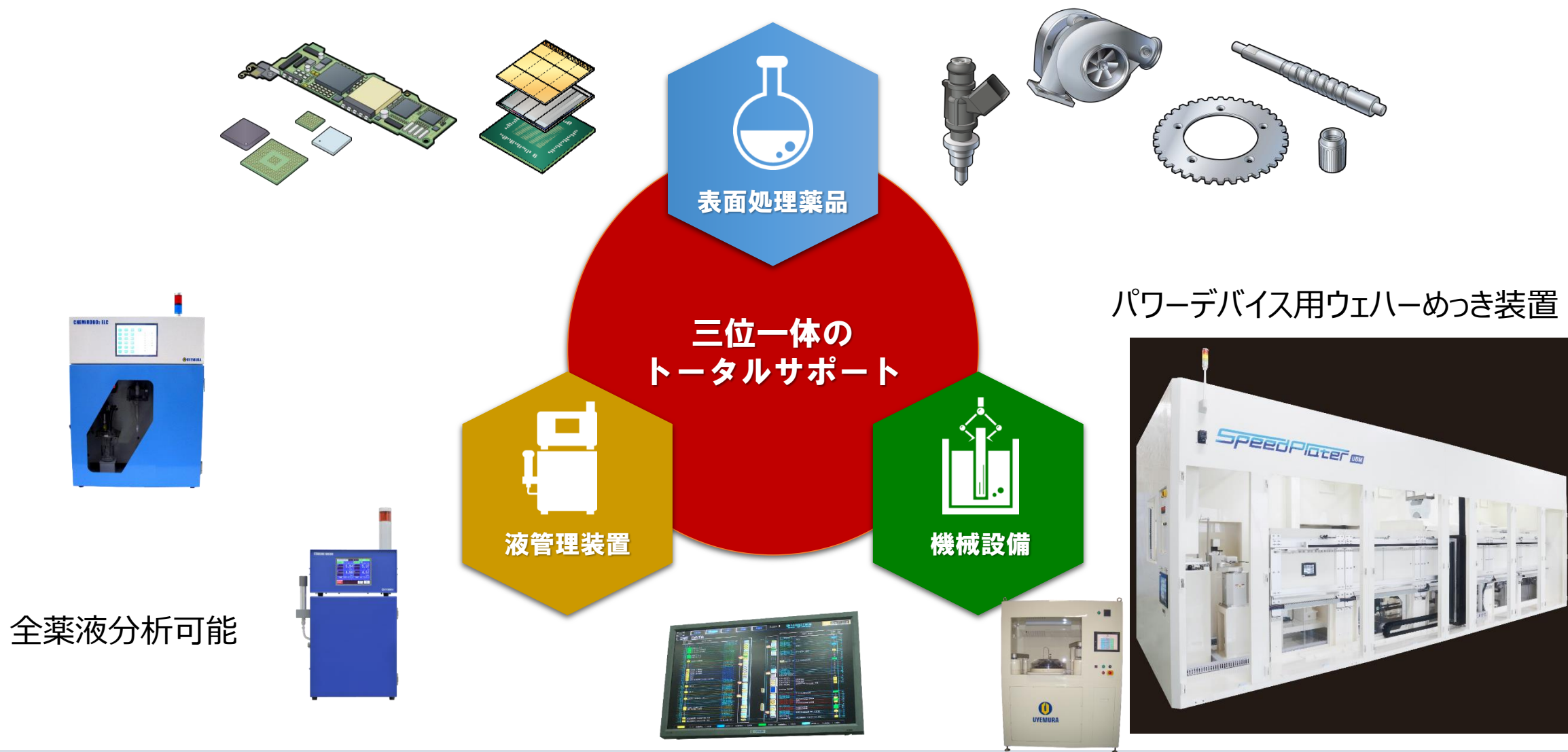
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を改定することについて決議し、本制度の改定に関する議案を2023年6月29日開催予定の第95期定時株主総会に付議することといたしました。具体的には、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする従来の「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」に加え、対象取締役の報酬と当社の業績との連動性を高めるべく、当社の取締役会が予め定める業績目標（ROE）の達成を譲渡制限解除の条件とする「業績条件型譲渡制限付株式報酬」を新たに導入いたします。詳細につきましては、2023年5月12日付プレスリリース「[譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ](#)」をご確認ください。

主要ビジネス状況

顧客満足度向上を目指す 誠心を以って実行に徹底する

- 市場占有率が高い市場では、更に市場占有率を高めるための営業および開発戦略
- 市場占有率が低い市場では、市場占有率を上げるための営業および開発戦略
- 市場の流れに合う製造戦略
- 薬品、機械および液管理装置のトータルソリューションの提供

営業基本戦略



➤ 現行市場状況

- ① 国内：通信、サーバー、PC関連は在庫調整により出荷が減少
パワーデバイスは落ち率は低く比較的堅調
- ② 海外：国内とほぼ同じ傾向。車載も同様
半導体関連は在庫調整が終われば潜在的に需要は戻ると予想

➤ 現在注力している技術

次世代PKG、通信向け基板技術、カーエレクトロニクス、環境関連技術

➤ 今後注力すべき技術

基板用微細配線技術、半導体バンプおよび配線技術

次世代接合材料向け表面処理、環境対応製品の開発

高密度パッケージ基板対応

小径ビアへの付きまわり向上低応力無電解銅めっき浴

半導体事業拡大

最先端半導体パッケージ用電解めっきプロセスの開発 (NEDO事業参加)

新規接合材料 (Ag焼結、Cu焼結) へ適したプロセスの開発

作業環境改善

密着向上剤によるデスミアフリープロセス

レアメタル使用量低減

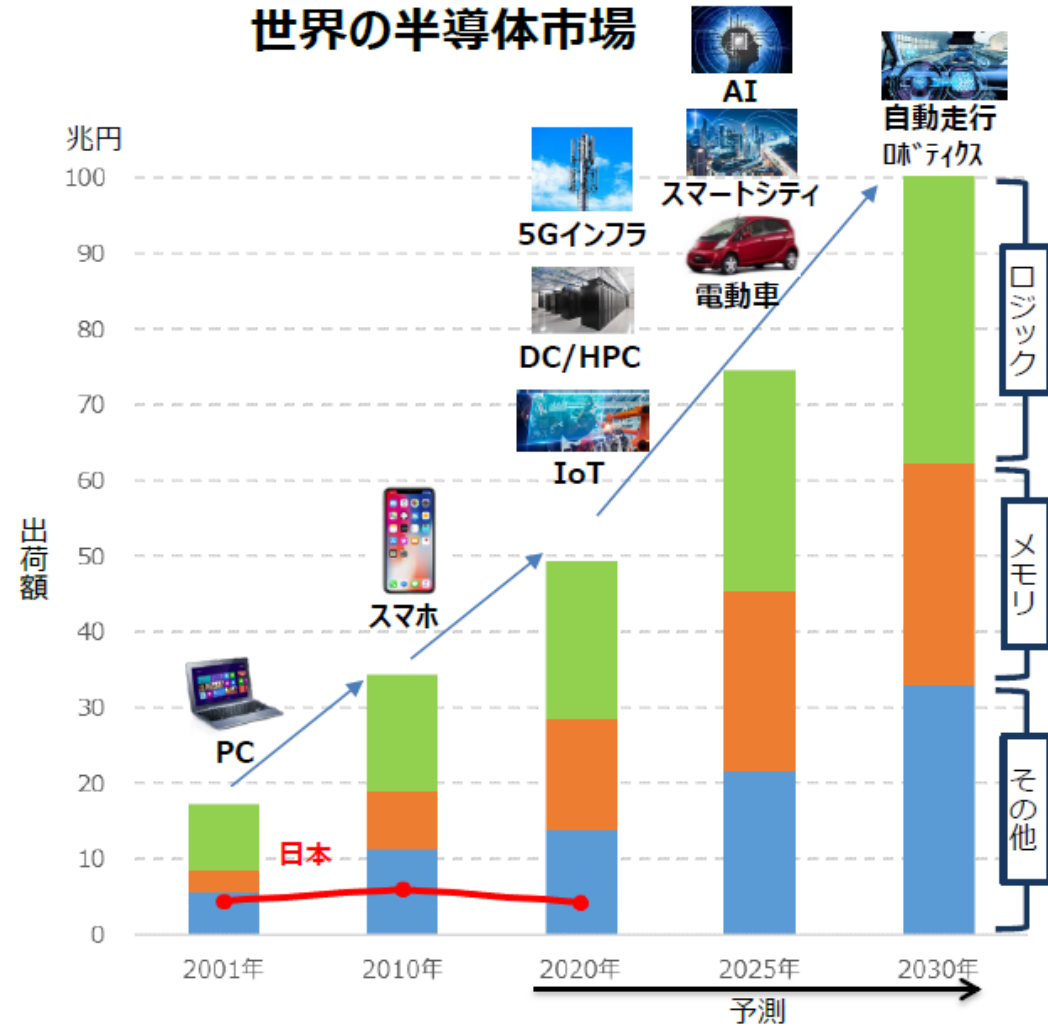
無電解銅めっき前処理プロセス酸洗添加剤による低濃度パラジウム触媒

環境負荷改善

電解銅めっき浴のリサイクルシステムによる廃液量低減

環境有害物質(フリーシアン, 鉛, ホルマリン等) を使用しないめっき浴

世界の半導体市場の動向

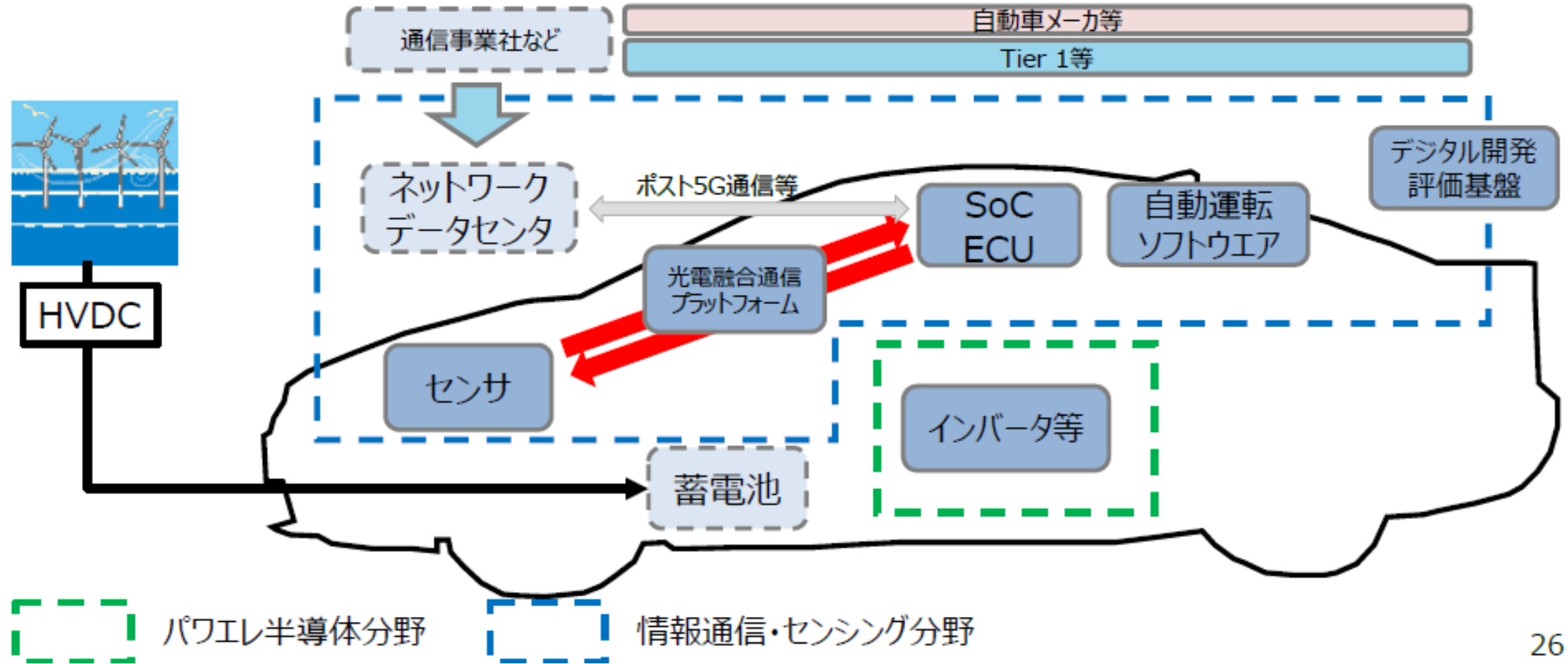


	市場規模 2018年	製品例	主要企業
ロジック (制御用)	21兆円	プロセッサ	intel tsmc
		GPU	QUALCOMM NVIDIA
		SoC	
メモリ (データ記憶用)	18兆円	DRAM	SAMSUNG SK hynix
		NAND	Micron KIOXIA
その他	15兆円	アナログLSI	Infineon SONY
		パワー半導体	ON Semiconductor
		イメージセンサ	MITSUBISHI ELECTRIC

(出典) Omdiaのデータを基に経済産業省作成 54

経済産業省：「半導体・デジタル産業戦略」まとめ(2021) 半導体戦略.PDF P54より

車載半導体の使用箇所



有機溶剤や過マンガン酸塩を有するデスミアプロセスを使用せず
平滑で高密着な回路形成が可能となるプロセスを開発

3ステップ処理

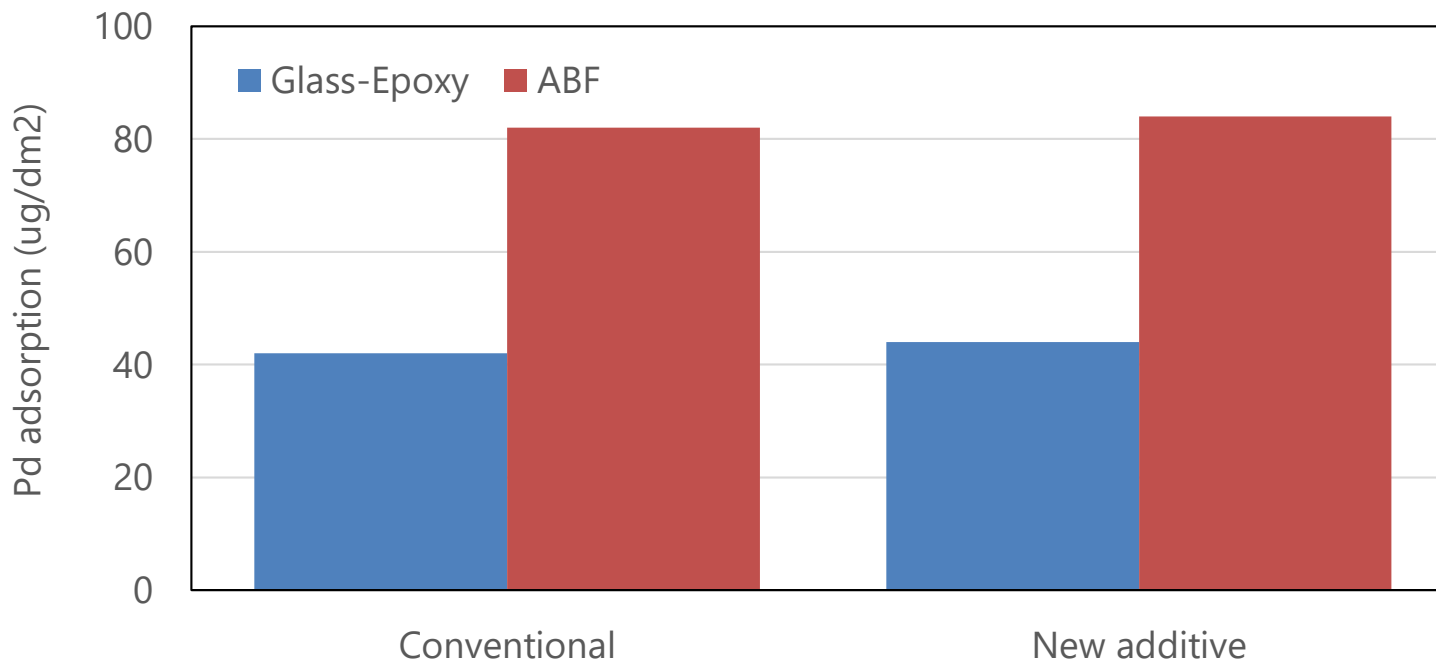
- 1 紫外線照射
- 2 密着向上処理
- 3 熱処理

無電解銅 + 電解銅後SEM断面観察 ×5000			
従来	銅めっき皮膜		
	ABF樹脂		
デスミア フリー			
	GL102	GL103	GY50



アクチベーターの前の酸洗処理に添加剤を加えることにより

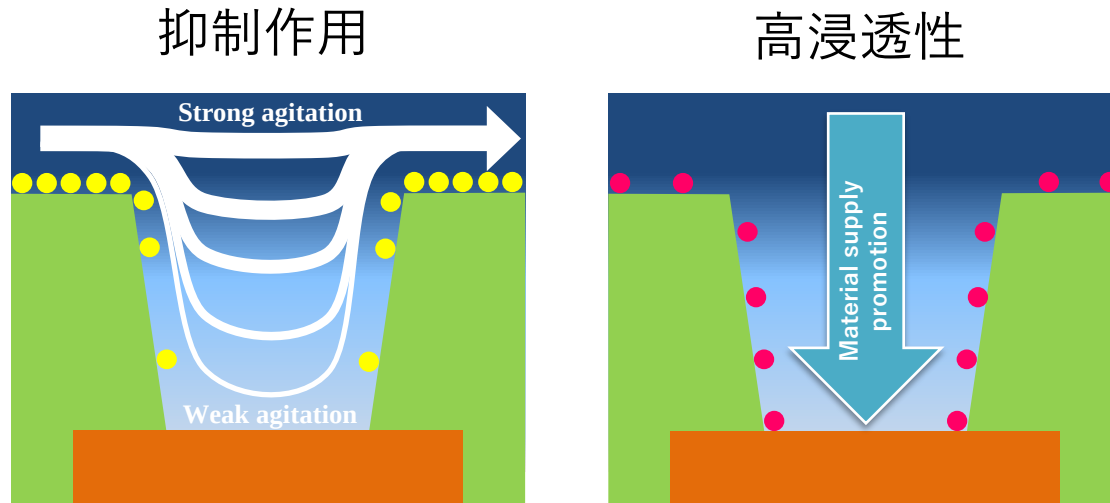
アクチベーター浴中のPd濃度を **200mg/L** ⇒ **50mg/L (75%削減)** にできるプロセスを開発

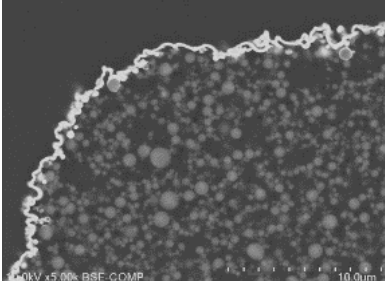
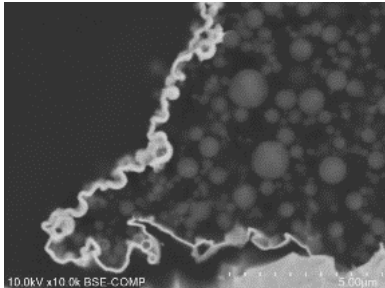


Pd濃度を減少させても、吸着量は変わらずめっき後の密着性や信頼性に問題はない

次世代パッケージ基板対応低応力無電解銅めっき浴

高密度パターン形成における0.2um以下のめっき膜厚にて、小径ビアへのめっき付きまわりが良好、かつ面内膜厚分布が良好な無電解銅めっき浴を開発



Thickness	30umΦ/35umh
Surface (x5,000)	0.199μm 
BVH Bottom (x10,000)	0.154μm 
Throwing power	77%

添加剤による抑制作用と高浸透性により小径ビアへの良好な付きまわりを実現

国内半導体事業拡大 NEDO事業参加

JOINT2コンソーシアム



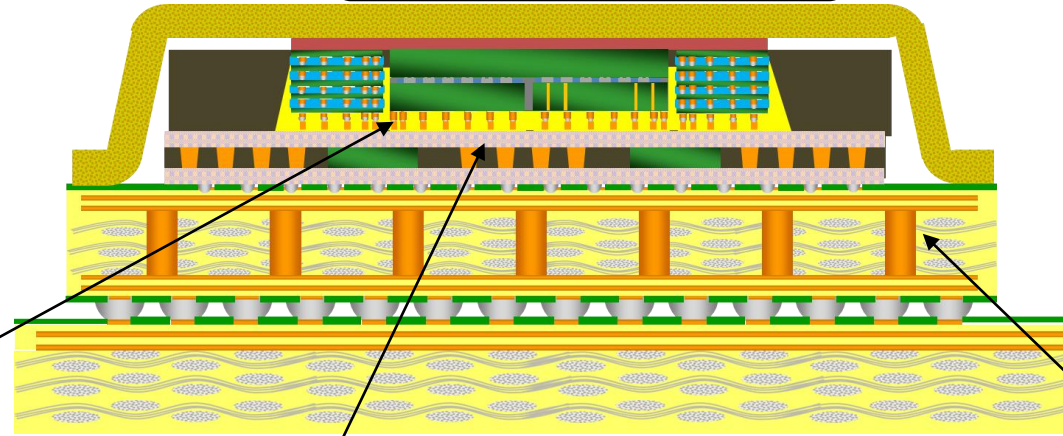
経済産業省ホームページ 内
 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発
 (助成)」採択結果一覧 20210531002-1.pdf より抜粋
<https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210531002/20210531002.html>

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業
 研究開発項目②先端半導体製造技術の開発
 採択結果一覧

No.	開発テーマ	実施体制(予定)
1	(b1) 高性能コンピューティング向け実装技術	TSMCジャパン3DIC研究開発センター株式会社 (共同実施先、協力企業等) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、イビデン株式会社、 多数の国内材料、製造装置メーカー、大学・研究機関(※企業・ 機関名は採択テーマ概要資料を参照)
2	(b2) エッジコンピューティング向け実装技術	先端システム技術研究組合 (共同実施先、組合員企業等) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、 株式会社SCREENホールディングス、ダイキン工業株式会社、富 士フイルム株式会社、パナソニックスマートファクトリリユーシ ムズ株式会社、国立大学法人東京大学
3		ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
4	(b3) 実装共通基盤技術	昭和電工マテリアルズ株式会社 (共同実施先、協力企業等) 味の素ファインテクノ株式会社、 上村工業株式会社 、株式会社荏 原製作所、株式会社新川、新光電気工業株式会社、大日本印刷 株式会社、株式会社ディスコ、東京応化工業株式会社、TOWA株 式会社、ナミックス株式会社、パナソニックスマートファクトリーソ リューションズ株式会社、ヤマハロボティクスホールディングス株 式会社
5		住友ベークライト株式会社

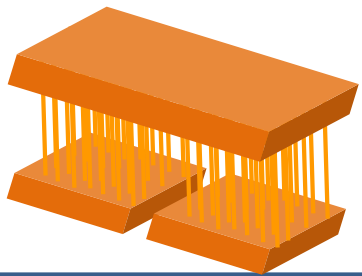
JOINT2コンソーシアム技術目標

2.xD/3Dパッケージ



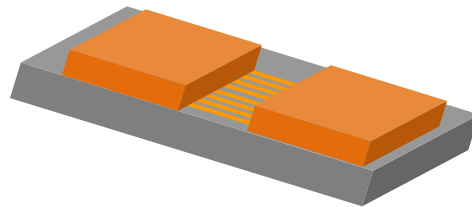
微細バンプ接合

Vertical interconnect



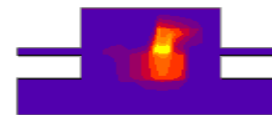
微細配線化技術

Lateral interconnect

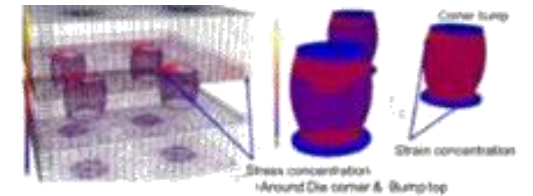


高信頼性パッケージ大型化

Thermal management



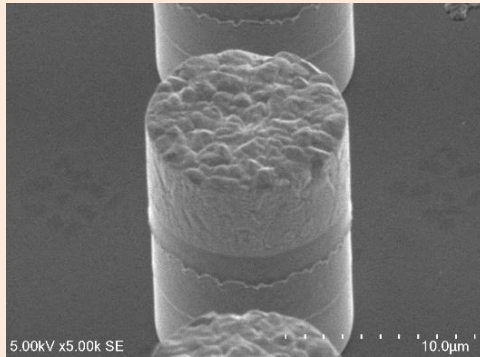
Stress management



JOINT2コンソーシアムにおけるウエムラの役割

微細バンプ接合

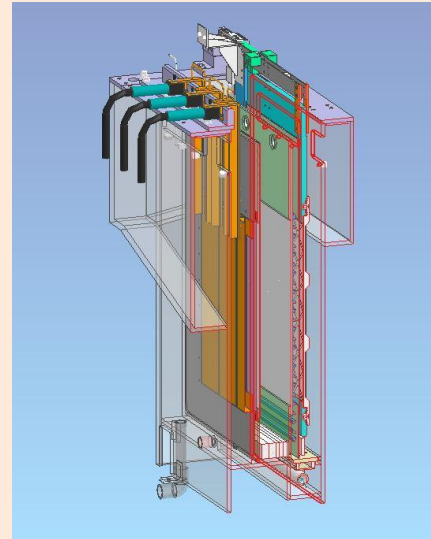
微細バンプ用 電解めっき液の開発



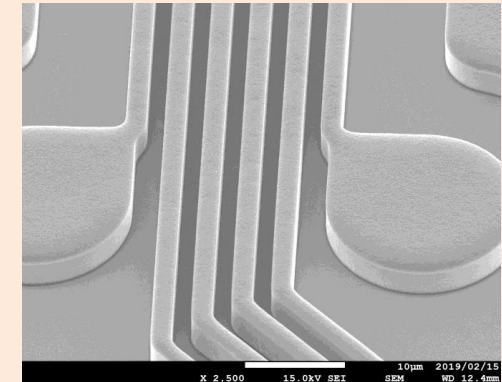
電解銅／ニッケル／錫-銀めっき
(バンプ径：10μm)

微細配線化

次世代パッケージ用 電解めっき装置の開発



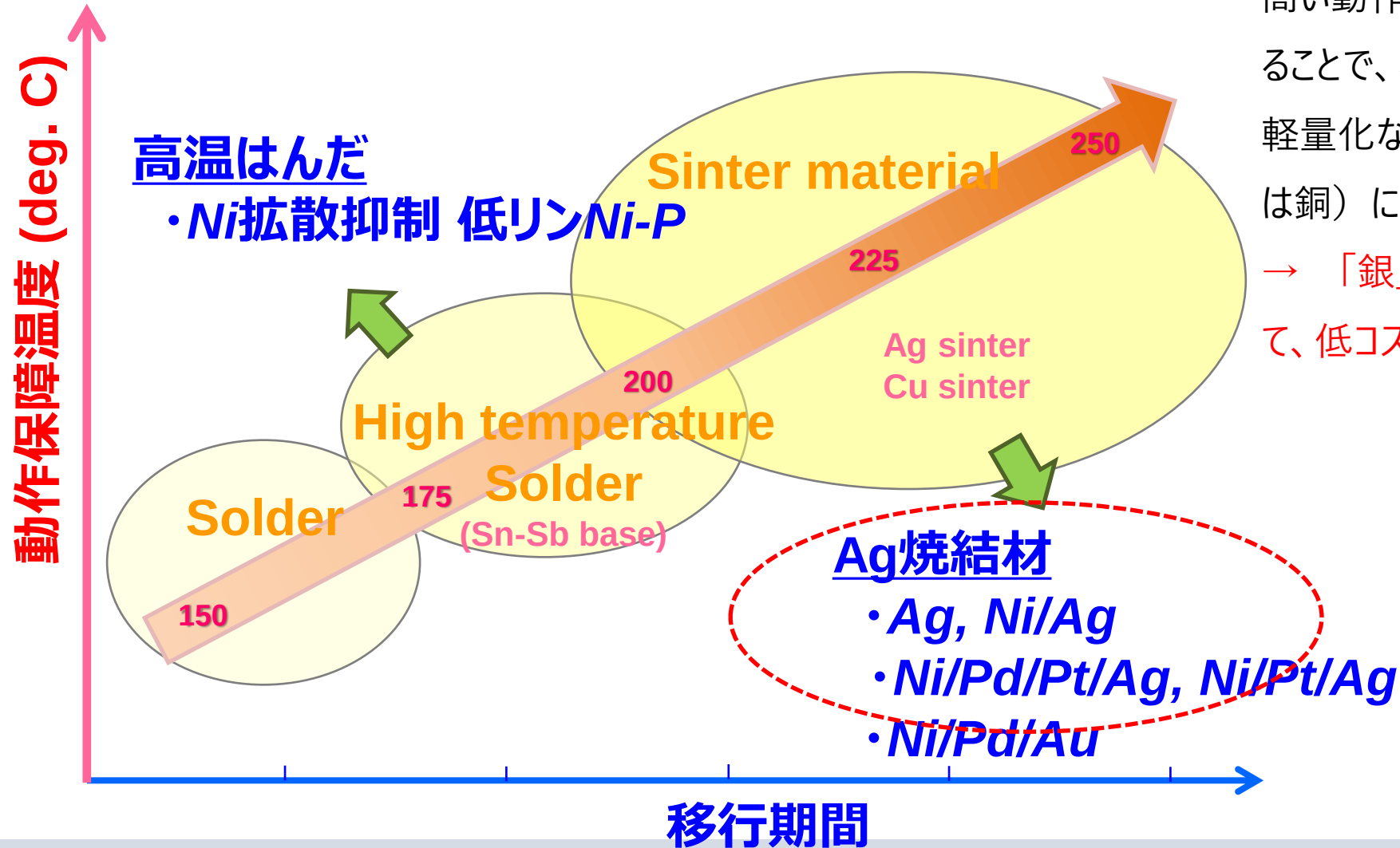
微細配線用 電解めっき液の開発



電解銅めっき
(配線幅：2μm)

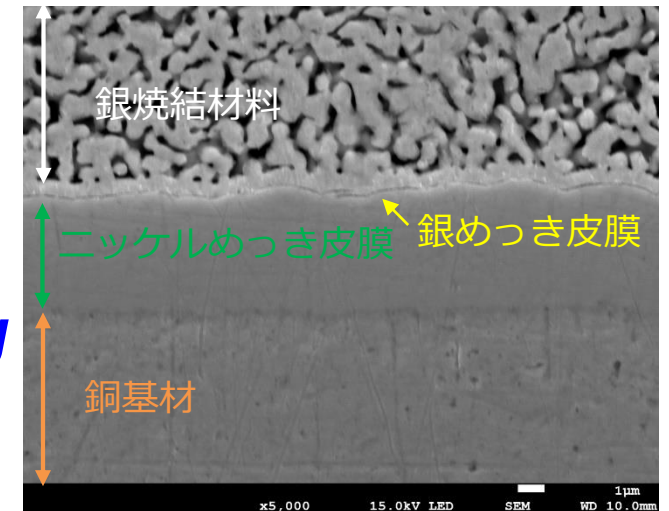
新規接合材料（銀焼結、銅焼結）へ適したプロセスの開発

パワー半導体向け動作温度と接合材料の変化



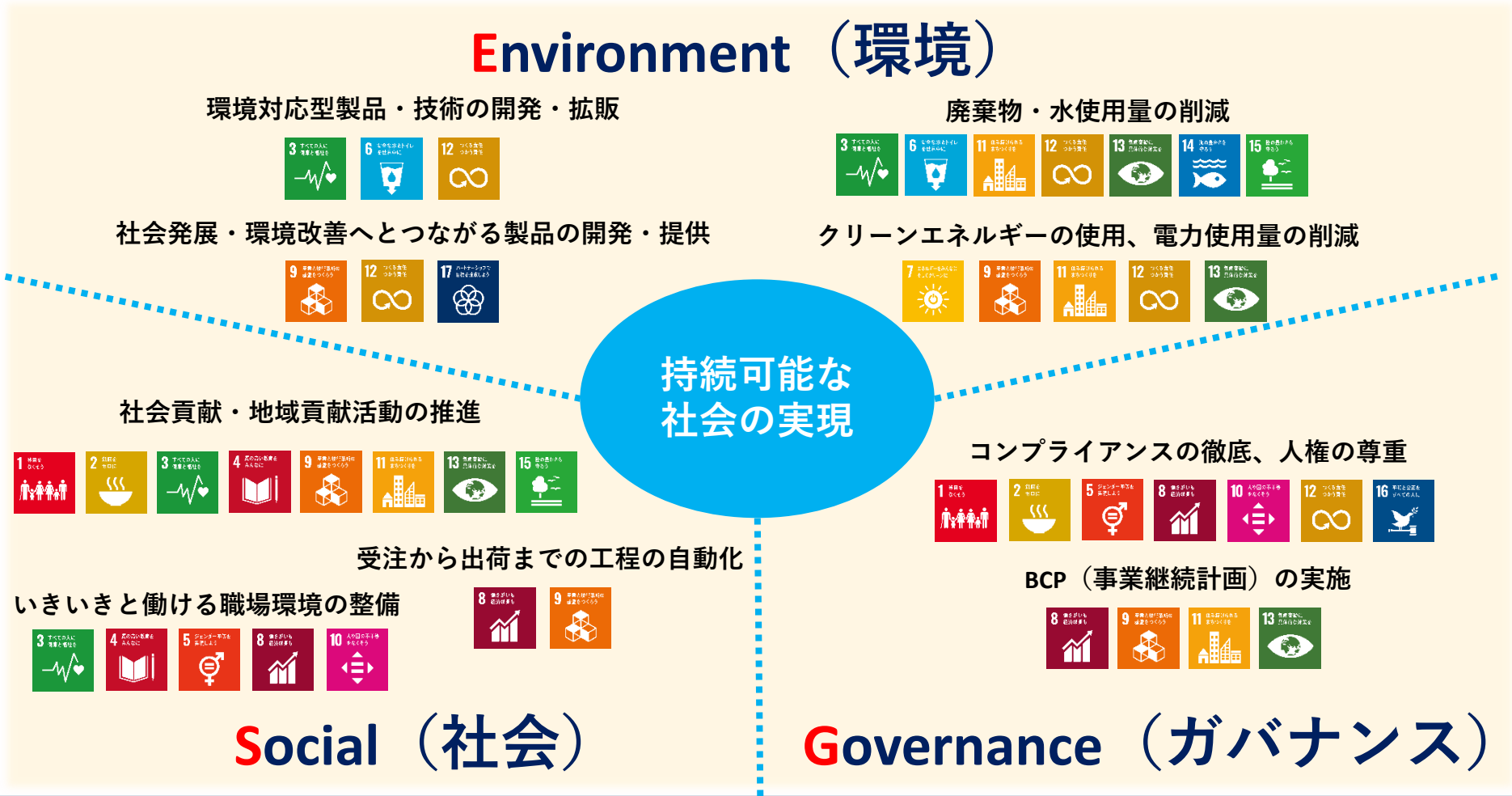
高い動作保証温度の部材を使用できるようになることで、様々な利点（インバーターの小型化、軽量化など）が得られるため、焼結材料(銀又は銅)に適した表面処理の提案が必要です。

→ 「銀」焼結材料に適した「銀」表面処理として、低コストなニッケル/銀皮膜を提案。



ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (UYEMURA:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています



環境対応製品 ～SDGsの積極的取り組み～

1. Pbフリーめっき浴

- ・無電解Niめっき浴。主に汎用浴向け。
- ・Pbフリーの電気Snめっき浴。純Sn、Sn-Ag浴など。電子部品向け。

2. シアンフリー浴

- ・シアンフリー & フリーシアン補給不要の無電解Auめっき浴。ウェハー、電子部品向け。

3. デスミアフリープロセス

- ・危険な過マンガン酸をつかわない基板向けプロセス。

4. ホルマリンフリー浴およびホルマリン不使用プロセス

- ・樹脂上へのダイレクトめっき（無電解Cu浴を使わない）。基板向け。
- ・ホルマリンフリー無電解Cu浴の開発。ウェハー向け。

5. PFOS, PFOAフリー浴

- ・PTFE複合めっき。主に車載部品向け。

6. 廃液処理

- ・めっき液リサイクルユニット



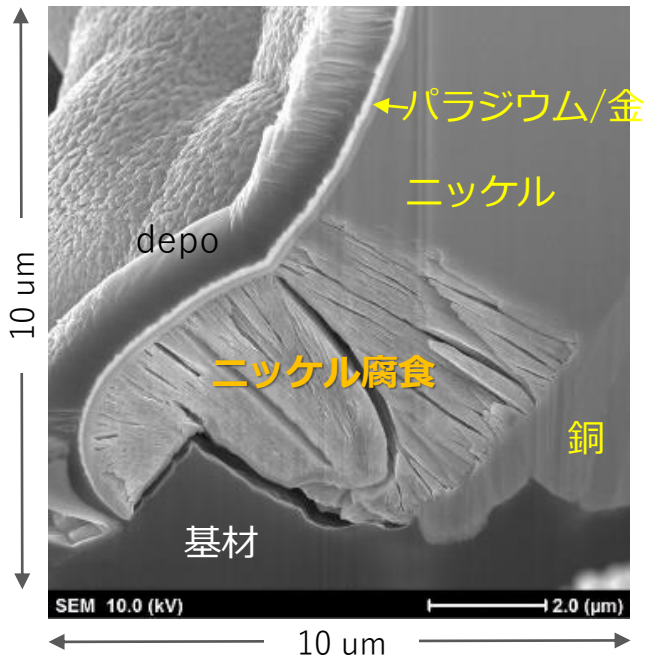
つくる責任、使う責任を果たす



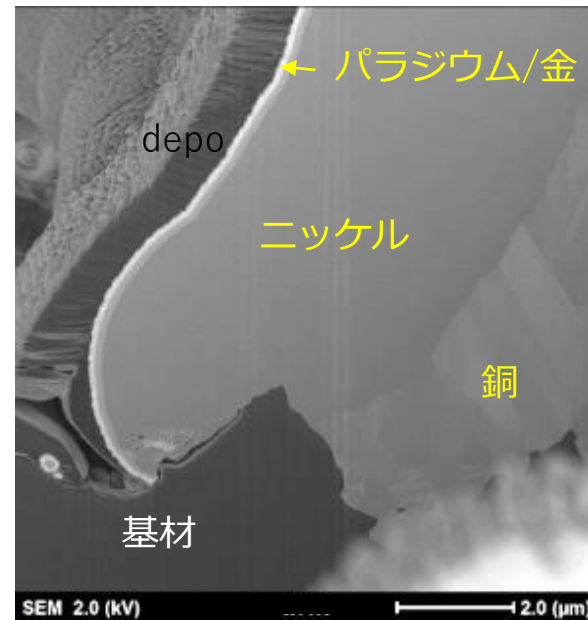


Ni腐食の比較した断面観察

従来



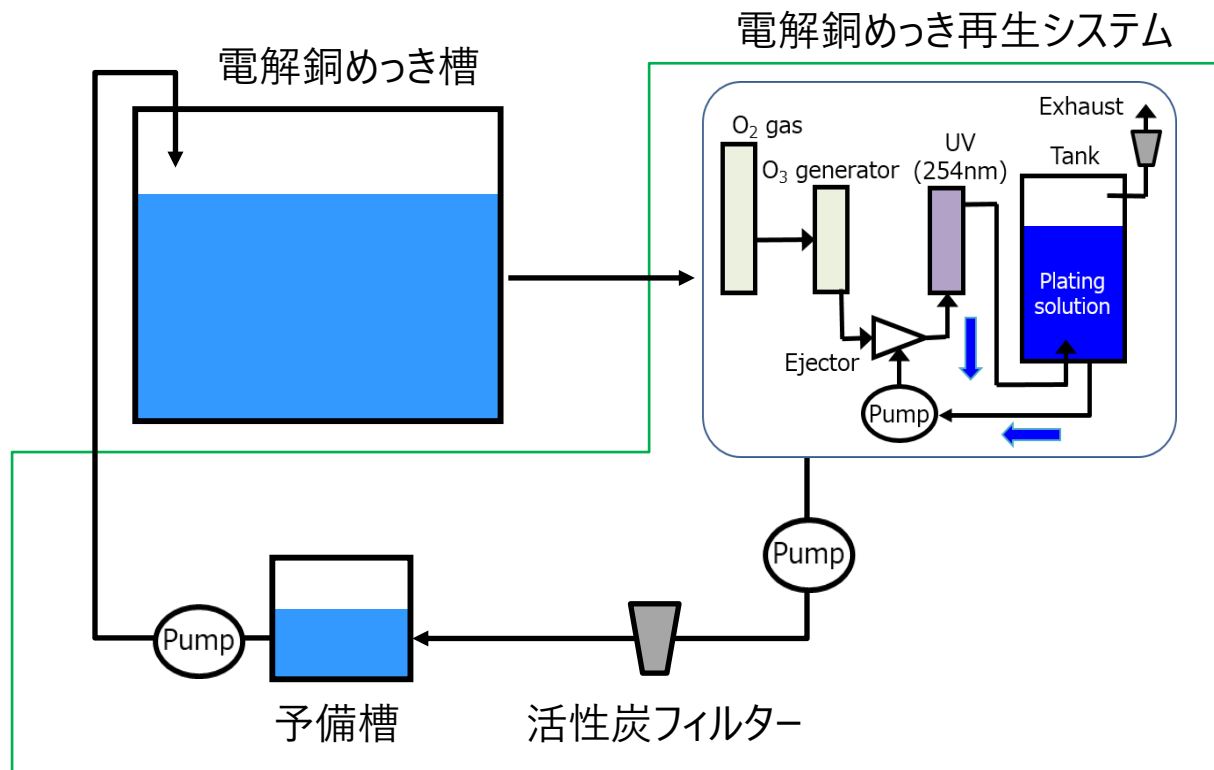
新規



貴金属めっきは一般的にフリーシアンを使用することで浴安定性や良好な皮膜性能を得ることが出来ます。主要な最終表面処理である無電解ニッケル/パラジウム/金工程において、フリーシアンを補給しない無電解金めっき液を用いると、下地のニッケル腐食を回避できませんでした。

→新規開発浴では、フリーシアンを補給することなく高品質なめっき皮膜を提供可能。

電解銅めっき 再生システムイメージ



電解銅めっき液は老化するに従い性能を阻害する不純物が蓄積するため、一定期間使用すると全量廃液→更新する必要があった。

この問題に対して「めっき液を部分的に再生システムで処理→めっき槽へ戻す」を繰り返しながら使用することで性能を一定に保ち理論上めっき液の寿命を半永久的に延ばすことが可能。

グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
株式会社サミックス	1963年	日本	
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

Growing together with



Uyemura Group Companies

• Japan	C.Uyemura & Co., Ltd. Sumix Corporation	• Taiwan	Taiwan Uyemura Co., Ltd.
• USA	Uyemura International Corporation	• Korea	Uyemura Korea Co., Ltd.
• Hong Kong	Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd.	• Singapore	Uyemura International (Singapore) Pte Ltd
• Shenzhen	Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd.	• Malaysia	Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd.
• Shanghai	Uyemura (Shanghai) Co., Ltd.	• Thailand	Sum Hitechs Co., Ltd.
		• Indonesia	PT. Uyemura Indonesia